

	Technisches Datenblatt Jtec Ag05CuP	Version / Datum	V1.0 / 04.05.2025
		Änderungsgrund	Neuerstellung
		Autor	TH
		Vorgängerversion	-

Jointec GmbH: Jtec Ag05CuP
 ISO 17672: CuP 281
 EN 1044: Cu 104
 AWS A 5.8: CuP-3

Chemische Zusammensetzung

	<i>Ag</i> [%]	<i>Cu</i> [%]	<i>P</i> [%]	<i>Andere</i> [%]	<i>Schmelzbereich</i> [°C]
Jtec Ag05CuP	5	Rest	6	-	645 – 815

Charakteristik / Anwendung

Jtec Ag05CuP ist ein Silber-Kupfer-Phosphor-Lot mit mittlerem Silberanteil. Diese Legierung bietet hervorragende Fliesseigenschaften und Kapillarwirkung. Geeignet für Verbindungen von Kupfer mit Kupfer.

Empfohlen für Lötverbindungen, die starken thermischen Belastungen und Vibrationen ausgesetzt sind.

Betriebstemperatur der Lötverbindung: –70 °C bis +150 °C.

Nicht geeignet für schwefelhaltige Umgebungen sowie für Eisen- oder Nickellegierungen.

Erwärmungsmethoden:

Flammlöten, Induktionslöten, Widerstandslöten

Flussmittel:

AgCuP werden zum Löten von Kupfer verwendet, dazu wird kein Flussmittel benötigt.

Technische Lieferbedingungen gem. ISO 17672

Verfügbarkeit

<i>Stäbe</i>	<i>Flussmittelummantelte Stäbe</i>	<i>Draht</i>	<i>Folie</i>	<i>Formteile</i>	<i>Pulver</i>	<i>Paste</i>
X	-	X	X	AA	-	-